

2024 6th International Conference on Circuits and Systems

ICCS 2024 is co-sponsored by University of Electronic Science and Technology of China and IEEE, hosted by University of Electronic Science and Technology of China

September 20-23, 2024 | Chengdu, China

Committees

CONFERENCE CHAIRS

Xinglai Ge, Southwest Jiaotong University

Weixin Gai, Peking University

Anquan Jiang, Fudan University

CONFERENCE CO-CHAIRS

Yuehang Xu, University of Electronic Science and Technology of China, China

Yuanqi Hu, Beihang University, China

Nan Qi, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences (CAS); Giovanni Crupi, University of Messina, Italy

PROGRAM CHAIRS

Letian Huang, University of Electronic Science and Technology of China

Jayakumari J., Mar Baselios College of Engineering and Technology

Yi Zou, South China University of Technology

Haruo Kobayashi, Gunma University, Japan

Jeff Kilby, Auckland University of Technology, New Zealand

PROGRAM CO-CHAIRS

Chaoyue Zheng, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou

Srikrishna C. Bodepudi, Zhejiang University, China

Esteban Tlelo-Cuautle, INAOE

TRACK CHAIRS

Maliang Liu, Xidian University

Gengen Liu, Fuzhou University

Jixin Zhang, Hubei University of Technology

Yibo Fan, Fudan University

Jing Jin, Shanghai Jiao Tong University

Zhao Zhang, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences

Haotong Shen, Zhejiang University

Zhangyong Chen, University of Electronic Science and Technology of China

Guohua Zhou, Southwest Jiaotong University

Dandan Ding, Hangzhou Normal University

Yijiu Zhao, University of Electronic Science and Technology of China

PUBLICITY CHAIRS

Caoyu Li, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou

Shuman Mao, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou

PUBLICATION CHAIR

Ling GONG, Southwest Medical University, China

Man XU, University of Electronic Science Technology of China, China

FINANCE CHAIR

Biao Pan, Beihang University

Special Session

<http://www.iccs.org/ss.html>

Chiplets Based Integrated Systems

- Advanced Packaging Technology
- Die-to-die Interface & Interconnect Technology
- Inter-Die Communication Network
- Chiplet-based Accelerator Design

Organizers:

Letian Huang, University of Electronic Science and Technology of China
Xiaohang Wang, Zhejiang University

Submission

Online submission system: <https://easychair.org/my/conference?conf=iccs20240>
Word template download: <http://www.iccs.org/files/conference-template-letter.docx>

Submission Deadline: 10th August, 2024

Contact

✉ Ms. Maggie X. Xu

✉ E-mail: iccs@chairmen.org

📞 Tel: 18080075398

>Wechat: iconf-ee

Keynote Speakers

Prof. Xiaoqing Wen,
Kyushu Institute of Technology,
Japan (IEEE Fellow)

Prof. Wei Hong,
Southeast University (IEEE Fellow)

Prof. Woogun Rhee,
Tsinghua University, China
(IEEE Fellow)

Invited Speakers

Prof. Haruo Kobayashi,
Gunma University, Japan

Prof. Hao Gao,
Southeast University, China

Assoc. Prof. Chao Fan,
Xi'an Jiaotong University, China

Assoc. Prof. Xianbo Li,
Sun Yat-sen University, China

Assoc. Prof. Junmin Jiang,
Southern University of Science and
Technology, China

Assist. Prof. Yuekang Guo,
Shanghai Jiao Tong University, China

Assist. Prof. Wenning Jiang,
Fudan University, China

Assist. Prof. Yufei Ma,
Peking University, China

Assist. Prof. Mo HUANG,
University of Macau, China

Assist. Prof. Lu Jie,
Tsinghua University, China

Assist. Prof. Mingqiang Guo,
University of Macau, China

Prof. Zhao Zhang,
Institute of Semiconductors, Chinese
Academy of Sciences, China

Prof. Miao Meng,
Tongji University, China

Assoc. Prof. Xiaoyong Xue,
Fudan University, China

Publication

IEEE Conference Proceedings

Accepted and registered full papers will be published by IEEE Conference Proceedings, included in IEEE Xplore, and submitted for Ei Compendex and Scopus, etc.

SCI+EI journal

Selected papers after extension will be recommended to the following journals:



Journal of Semiconductors

Indexing: EI, ESCI, Scopus, etc.



*International Journal of Numerical
Modelling: Electronic Networks, Devices
and Fields*

Indexing: SCI, EI Compendex, Scopus, etc.



*Computer Technology and
Development*



*Journal of Electronic Science and
Technology*

Indexing: Ei Compendex, Scopus, etc.

Topics Interested

<http://www.iccs.org/cfp.html>

Track 1: Analog and Nonlinear Circuits Design

Chair: Maliang Liu, Xidian University, China

Track 2: VLSI Design & Electronic Design Automatic

Chair: Gengen Liu, Fuzhou University

Chair: Jixin Zhang, Hubei University of Technology

Track 3: Circuits and Systems for Signal Processing

Chair: Yibo Fan, Fudan University

Chair: Dandan Ding, Hangzhou Normal University

Track 4: RF & Communication Circuits

Chair: Jing Jin, Shanghai Jiao Tong University

Chair: Zhao Zhang, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences

Track 5: Design for Test & Reliability

Chair: Haoting Shen, Zhejiang University

Track 6: Power Electronic Circuits

Chair: Guohua Zhou, Southwest Jiaotong University

Track 7: Control Aspects of Circuits and Systems

Chair: Zhangyong Chen, University of Electronic Science and Technology of China

Track 8: Circuits and Systems for Instrumentation and Measurement

Chair: Yijiu Zhao, University of Electronic Science and Technology of China

Co-sponsored by



Hosted by



Co-Organizer



Patrons



2024年第六届电路与系统国际会议

2024年第六届电路与系统国际会议将于2024年9月20-23日在中国成都召开。

热忱欢迎从事相关领域研究的专家学者踊跃投稿。

2024年9月20-23日,中国成都

组委会

大会主席

葛兴来, 西南交通大学
盖伟新, 北京大学
江安全, 复旦大学

大会联合主席

徐跃杭, 电子科技大学
胡远奇, 北京航空航天大学
祁楠, 中国科学院大学
Giovanni Crupi, 意大利墨西拿大学

程序委员会主席

黄乐天, 电子科技大学
Jayakumari J., Mar Baselios工程技术学院
周毅, 华南理工大学
小林春夫, 日本群马大学
Jeff Kilby, 新西兰奥克兰理工大学

程序委员会联合主席

郑朝月, 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Srikrishna C. Bodepudi, 浙江大学
Esteban Tlelo-Cuatle, INAOE

分会主席

刘马良, 西安电子科技大学
刘耿耿, 福州大学
张吉昕, 湖北工业大学
范益波, 复旦大学
金晶, 上海交通大学
张钊, 中国科学院半导体研究所
沈浩颋, 浙江大学
陈章勇, 电子科技大学
周国华, 西南交通大学
丁丹丹, 杭州师范大学
赵贻玖, 电子科技大学

宣传主席

李草禹, 电子科技大学长三角研究院(湖州)
毛书漫, 电子科技大学长三角研究院(湖州)

出版主席

Ling GONG, 西南医科大学
Man XU, 电子科技大学

财务主席

潘彪, 北京航空航天大学

专题研讨

<http://www.iccs.org/ss.html>

基于芯粒的集成系统

- 高级封装技术 ■ 裸片间接口与互连技术
- 裸片间互连网络 ■ 基于芯粒的加速器设计

组织者: 黄乐天, 电子科技大学

王小航, 浙江大学

投稿指南

在线投稿: <https://easychair.org/my/conference?conf=iccs20240>

邮箱投稿: iccs@chairmen.org

全文WORD模板下载: <http://www.iccs.org/files/conference-template-letter.docx>

全文LATEX模板下载: <http://www.iccs.org/files/conference-latex-template>

投稿截止: 2024年8月10日

联系方式

许老师

邮箱: iccs@chairmen.org

电话: 18080075398

微信: [iconf-ee](#)

主旨报告



温晓青 教授
日本九州工业大学 | IEEE会士



洪伟 教授
东南大学 | IEEE会士



李宇根 教授
清华大学 | IEEE会士

邀请报告



Haruo Kobayashi 教授
日本群马大学



高昊 教授
东南大学



樊超 副教授
西安交通大学



李显博 副教授
中山大学



姜俊敏 副教授
南方科技大学



过悦康 助理教授
上海交通大学



江文宁 助理教授
复旦大学



马宇飞 助理教授
北京大学



黄沫 助理教授
澳门大学



揭路 助理教授
清华大学



郭铭强 助理教授
澳门大学



张钊 教授
中国科学院半导体研究所



孟森 教授
同济大学



薛晓勇 副教授
复旦大学

会议出版

IEEE 会议论文集

会议接收并注册的全文将出版至IEEE会议论文集, 收录至IEEE Xplore, 并于会后提交EI核心和Scopus检索。

SCI+EI核心特刊

优秀论文扩展之后, 将推荐至以下期刊:



半导体学报

检索: EI核心, ESCI, Scopus 等。



International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
检索: SCI, EI Compendex, Scopus, etc.



《计算机技术与发展》



Journal of Electronic Science and Technology
检索: Ei Compendex, Scopus, etc.

征稿主题

更多详情请访问: <http://www.iccs.org/cfp.html>

专题一: 模拟与非线性电路设计

组织者: 刘马良, 西安电子科技大学

专题二: 大规模集成电路设计与电子设计自动化

组织者: 刘耿耿, 福州大学

组织者: 张吉昕, 湖北工业大学

专题三: 面向信号处理的电路与系统

组织者: 范益波, 复旦大学

组织者: 丁丹丹, 杭州师范大学

专题四: 射频与通信电路

组织者: 金晶, 上海交通大学

组织者: 张钊, 中国科学院半导体研究所

专题五: 可测性设计与可靠性设计

组织者: 沈浩颋, 浙江大学

专题六: 电力电子电路

组织者: 周国华, 西南交通大学

专题七: 电路与系统的控制方向

组织者: 陈章勇, 电子科技大学

专题八: 用于仪器和测量的电路与系统

组织者: 赵贻玖, 电子科技大学